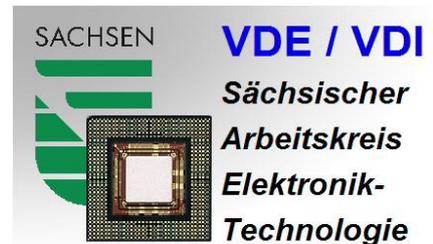


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
01069 Dresden
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de



65. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Thema: **Trends und Herausforderungen an die moderne Elektronikfertigung**

Am **Mittwoch, den 7. Oktober 2015** bei der **TURCK BEIERFELD GMBH.**

Programm:

- 10:00 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Turck Beierfeld GmbH
Herr Prof. Bauer & Herr Grünert
- 10:20 Uhr Traceability in der Elektronikfertigung
Frau Bernhardt, Turck Beierfeld GmbH
- 10:50 Uhr Herausforderung Industrie 4.0
Herr Blömer, ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
- 11:20 Uhr Trends in der Leiterplattentechnologie
Herr Süß, KSG Leiterplatten GmbH
- 11:45 Uhr *Kaffeepause*
- 12:00 Uhr Das Werner-Hartmann-Zentrum für Technologien der Elektronik
Herr Prof. Zerna, ZmP der TU Dresden
- 12:30 Uhr Technologie Laserlöten – Möglichkeiten und Grenzen
Herr Wolf, Turck Beierfeld GmbH
- 13:00 Uhr *Mittagsimbiss*
- 14:00 Uhr Fertigungsrundgang in mehreren Gruppen
- 15:00 Uhr Abschlussdiskussion

Die Organisation bei der Turck Beierfeld GmbH hat freundlicher Weise Herr Jörg Seidel übernommen. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumkapazität auf 50 begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung (**spätestens bis Mittwoch, den 30.09.2015**) bei Herrn Dr. Oppermann (martin.oppermann@tu-dresden.de).

Adresse:
Turck Beierfeld GmbH
Am Bockwald 2
08344 Grünhain-Beierfeld

<http://www.turck.de/de/beierfeld-2242.php>